



## 株主・投資家のみなさまへ

第50期 中間報告書 2009.4.1 - 2009.9.30



### 株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会の議決権 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日
公告方法	電子公告により、当社ホームページ ( <a href="http://www.jcu-i.com/">http://www.jcu-i.com/</a> )※に掲載いたします。 なお、やむを得ない事由により、電子公告による ことができないときは、日本経済新聞に掲載して 行うものとします。 ※2009年10月1日より変更いたしました。
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
電話お問合わせ先・ 郵便物送付先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-288-324(フリーダイヤル)
証券コード	4975
金融商品取引所	東京証券取引所市場第一部



### 荏原ユーザライト株式会社

〒110-0016 東京都台東区台東4-19-9 山口ビル7  
TEL: 03-3833-0321 FAX: 03-3833-5075  
<http://www.jcu-i.com/>

株主様向け  
アンケート

## 株主の皆様の声をお聞かせください

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記URLにアクセスいただき、  
アクセスコード入力後に表示される  
アンケートサイトにてご回答ください。  
所要時間は5分程度です。

<http://www.e-kabunushi.com>  
アクセスコード 4975

いいかぶ

検索

Yahoo!, MSN, exciteのサイト  
内にある検索窓に、いいかぶと  
4文字入れて検索してください。

空メールによりURL自動返信

kabu@wjim.jpへ空メールを送信してください。(タイトル、本文は無記入)  
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

携帯電話からもアクセスできます

QRコード読み取り機能のついた携帯電話をお使い  
の方は、右のQRコードからもアクセスできます。



●アンケート実施期間は、本書がお手元に  
到着してから約2ヶ月間です。

ご回答いただいた方の中から  
抽選で薄謝(図書カード500円)  
を呈させていただきます



※本アンケートは、株式会社エーツメディアの提供する「e-株主リサーチ」  
サービスにより実施いたします。(株式会社エーツメディアについての詳細  
<http://www.a2media.co.jp>) ※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させ  
ていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

●アンケートのお問合わせ TEL: 03-5777-3900 (平日 10:00~17:30)  
「e-株主リサーチ事務局」 MAIL: info@e-kabunushi.com



地球環境に配慮した大豆油  
インキを使用しています。

## 株主・投資家のみなさまへ



荏原ユーザイト株式会社  
代表取締役社長

粕谷 佳久

株主・投資家のみなさまには、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

当社グループの第2四半期累計決算につきましては、国内、海外子会社合計で売上高41億91百万円、営業利益1億47百万円、経常利益1億93百万円、純利益59百万円となりました。

### 国内の状況

当上半期を振り返れば、日本では、自動車関連事業は4～6月と順次回復基調になったとはいえ、稼働率は45%～50%が60%～65%までやっと回復したに過ぎず、7～9月になって、政府のエコカー補助金対策効果もあって、60%～65%が70%～75%に回復した状況で、日本の自動車生産は当社の売上状況とほぼリンクしていると考えられます。一方、半導体、プリント配線板の業界は、4～6月から携帯電話や小型パソコン向けに急速に回復し、上半期通算で前年度の売上高の70%～80%程度の回復状況にあります。

しかし、クリスマス商戦を前にして仕事量は9月中旬から次第に縮小傾向が見られ、下半期の状況は現在のところ、悲観する必要はないが、楽観もできない微妙な状況にあります。

### 海外の状況

一方、海外に目を移すと、当社の第1四半期に計上された1～3月の売上高は1月分は過去最低の金額で、前年度の25%～30%程度から、2月末から3月にかけて60%～70%まで急回復するという状況となりました。第2四半期に計上される4～6月の状況はほぼ80%～90%となっております。中国の自動車生産台数は9月末の時点ですでに1,000万台を突破し、1,300万台に近づく勢いで、アメリカ、日本を抜いて、世界第1位となると予想されています。

### 中国戦略

当社もそれに対応するため、上海、広州の全社員を自動車関連事業に特化させ、一方、エレクトロニクス用薬品拡販のため、特に携帯電話をはじめとする3G化に対応するために、ビルドアップ基板の専門チームを台湾を中心として深圳に新しい拠点を開設して、拡販に努めさせることにしました。また、為替リスク対策として、中国、台湾、タイ、韓国で現地生産化を進めております。

上半期の売上不振の原因は申し上げるまでもなく、リーマンショックによるアメリカ発の世界不況によるものですが、各国の不況対応策の違いにより、各国ごとに回復状況はまちまちなのです。

中国の場合は、国家主導の下に輸出依存体質の脱却を図り、いち早く国内需要を喚起させるべく、60兆円近い財政支出をとったので、昨年10月、11月はさすがに前年同月比で15%～20%の落ち込みとなりましたが、12月から回復基調になっており、今年1月から始まる当上半期は中国に助けられた感があります。

韓国は3月から、台湾は4月から、国内に先駆けて回復しました。従って、上半期の利益は国内赤字かゼロ、海外黒字となり、トータルしてほんの少々黒字の決算が出来たというのが本音であります。

リーマンショック後の世界経済は回復傾向にあるとはいえ、雇用状況が全然改善されず、失業率の上昇が止まらない状況が世界中で起こっており、消費の低迷と民間の設備投資不足は深刻で、当社も中国以外ほとんど設備計画は具体化しないため、装置部門の不振は、今期中続くものと覚悟しています。

### 表面処理のトップメーカーとしてのチャレンジ —環境をキーワードにして—

しかし、当社は自動車業界の大変革期をどう乗切るか、技術革新力と国内外の市場開拓力を総動員していく以外生き残れないと考えております。

めっきという湿式プロセスとドライという乾式プロセスの融合による新しい技術分野を、環境をキーワードとして切り拓くと同時に、ハードコーティングと熱処理を組み合わせた新しい合弁事業にも取り組み、反射防止膜による太陽光発電パネルの大幅な太陽光発電効率アップとコストダウンを図り、環境対策事業として育成したいと考えております。

また、めっき関連会社の屋根に、太陽光発電装置を載せる事業にも参入し、すでに3社の受注を内定しております。

政府のCO<sub>2</sub>削減策が本気なら、必ず私たちに大きなチャンスが訪れるものと期待しております。

超親水性膜のコーティング技術にも成功しており、色々な分野でその機能が評価され、使用させるものと確信しております。

### 開発製品化戦略 —スピードとコストの勝負—

一方、総合研究所の方でもビルドアップ配線板ビアフィリング用銅めっきプロセスVFⅣという平坦且つ微細な配線板向け薬品やスルーホールフィリング用銅めっきプロセスTFⅡの開発や拡販をスタートさせており、次世代のTSV対応プロセスBUⅡの開発にも成功しており、世界中の業界から期待されています。

なお、当社の悲願であった貴金属めっき分野への進出も発表しました。従来のニッケル・金プロセスだけでなく、次世代向けニッケル・パラジウム・金めっきの分野に積極的に参入します。すでに大手台湾各社のプレゼンテーションの依頼やサンプル加工に追われている今日今頃です。

つまり、めっき技術の世界最先端を目指すことと、時代の大きな変革に対応するための新しい環境問題を念頭において技術開発と導入をしっかりと進めることにより、不況の中にあっても一段と飛躍できるようにしたいと考えております。

海外拠点の一層の充実と強化、ブラジルをはじめとする新しい拠点作りにも邁進したいと考えております。

現在は、スピードとコストが勝負の時代であり、世界の政治、経済活動の動向に注意しながら、勇気ある行動と決断が我々経営陣に求められています。

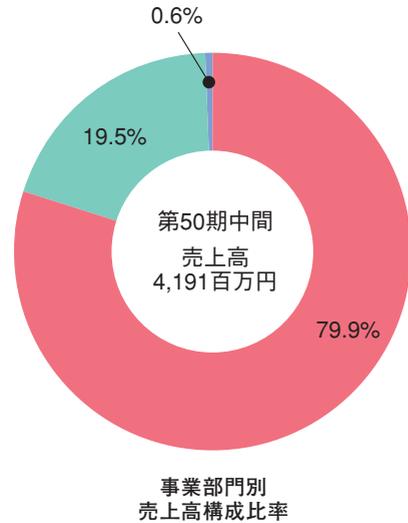
株主・投資家のみなさま方の熱烈なご支援とご協力を切にお願い申し上げます。

2009年12月

当社の製品・事業内容について、セグメント別概況とともにご紹介いたします。

当社グループは、当社と連結子会社8社、関連会社1社により構成され、めっきを中心とする表面処理薬品と装置を、自動車、建材、水栓金具、電子部品、半導体等の様々な分野に提供する表面処理メーカーグループであります。特に、プロセスからアフターフォロー等までを含めた総合的な提案と提供を行い、顧客要望にマッチした開発、製造及び販売に努めております。

当社グループにおける事業の種類別セグメントは、「薬品関連資材事業」「装置事業」「ドライ事業」に区分しております。



### 薬品関連資材事業

薬品関連資材事業では表面処理薬品の製造販売と関連資材の仕入販売を行っております。表面処理薬品は販売対象市場により、自動車部品や水栓金具等への装飾を目的としためっき用薬品や、建築部品等への防錆を目的としためっき用薬品等を主要製品とする「基幹分野向け表面処理薬品」と、エレクトロニクス業界において、プリント配線板や電子部品等を製造する工程で使用されるめっき用薬品を主要製品とする「電子分野向け表面処理薬品」に分類しております。



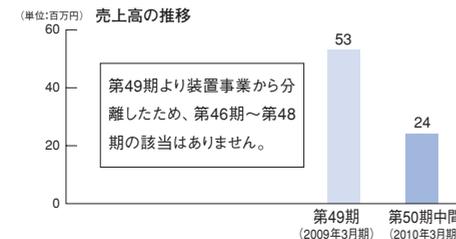
### 装置事業

装置事業では自動車部品やプリント配線板等の全自動表面処理装置の製造販売を行っております。また、表面処理装置の販売に付随して、ろ過機や洗浄装置等に代表される付帯機器の製造販売も行っております。



### ドライ事業

当社は創業以来、ウェット(湿式)技術を中心とした製品の開発及び販売を行ってまいりました。しかし、近年では顧客ニーズが多様化してきており、ウェット技術だけでは十分な対応ができなくなってきております。そこで当社は、ウェット技術とドライ(乾式)技術との融合によりこの問題の解決を図ることいたしました。ドライ事業では、プラズマ技術を用いたプリント配線板の洗浄装置の製造販売、スパッタリング技術を用いたカラーリング事業、めっき液の自動分析管理装置の製造販売を行っております。



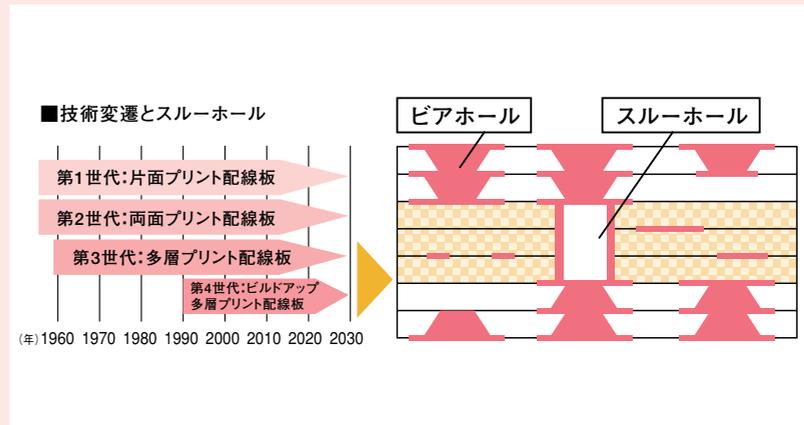
新プロセスの主な用途

この技術は、一言で表現すると電子機器の高性能化、小型化に必要な技術です。身近な用途例としては、携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、薄型テレビなどがあげられます。

スルーホールフィリング用硫酸銅めっきプロセス

新プロセス開発の背景

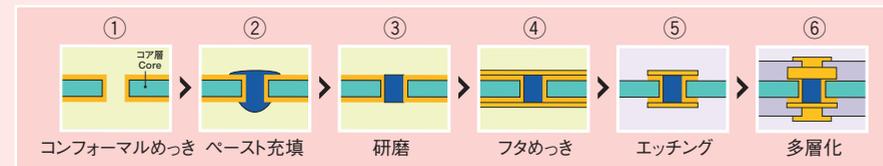
コア基板と呼ばれる2層から6層などの多層配線板の表面及び裏面に、エポキシ樹脂やBT(ビスマレイミドトリアジン)樹脂による絶縁層をラミネートし、レーザーにて形成したブラインドビアホールを介してサブトラクティブ法やセミアディティブ法にて銅めっきによる微細配線とビア部の導通を行う方法をビルドアップ工法といいます。ビルドアップ基板は配線の高密度化にともない、ブラインドビアをめっきで穴埋めすることが求められました。当社がこの穴埋めめっきに必要な添加剤(VFシリーズ)を販売したところ、市場から高い評価をいただき、販売量が飛躍的に増加しています。



当社は、このVFシリーズに加え、ビルドアップ基板の性能をより高めるとともに、コスト低減を目的として、コア基板のスルーホールを銅めっきでフィリングするプロセスを開発し、TFというブランドネームで市場に投入しました。このプロセスによる操業はすでに台湾で始まっており、国内においても、採用が見込まれています。

従来工程

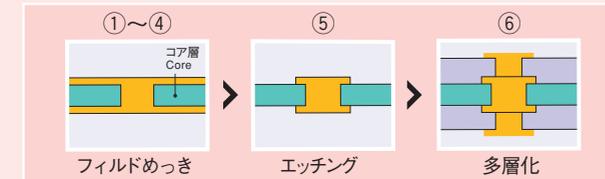
従来のスルーホールフィリングの工程は下図のとおりです。



従来の工程では、まずめっきの工場①で①番目の工程が終わった後、配線板が別の工場へ搬入され、ペースト充填と研磨の作業が施されます(②～③)。その後再びめっきの工場へ搬入され、最後まで加工されます(④～⑥)。

当社開発のめっきプロセス

従来の6工程のうち、①から④までを一つのめっき工程に短縮することができ、大幅な生産性の向上や製造コストの削減が期待できます。



200μm厚コア層スルーホールフィリングの加工例



スルーホールフィリングめっきの特長

- 1 特別な電源を使用せず、直流電源を使用する。
- 2 添加剤を分析して数値管理ができる。
- 3 1プロセスでスルーホールフィリング、ビアフィリングが可能である。
- 4 フラット性を維持したままでのハーフエッチが可能である。

利点

製造工程の簡略化 (6工程 → 3工程)	放熱性、導電性の向上
製造コストの低減	接続信頼性の向上

当社業績への貢献

国内、海外への拡販を積極的に取り組んでおり、すでに海外の一部の企業では採用されました。現在、国内でもいくつかの大手メーカーにてテスト中で、順調に進めば、電子分野でのシェアの拡大が期待できます。

台湾での市場性

台湾市場の特徴として、「携帯電話向けパッケージ基板の生産量世界No.1」と「ファブリー(請負)ビジネスが得意」という2つがあります。前者ではCSP(チップサイズパッケージ)部品基板として今後もスルーホールフィリングが多用されると予想されます。後者は、海外メーカー(例えば日本や韓国)からのCSP部品及びFC(フリップチップ)基板の委託生産を受け入れる方向が見受けられます。これにより、台湾はCSP及びFCのスルーホールフィリング世界工場になるのも遠い日ではないかもしれません。

すでに、当社のスルーホールフィリングめっきは数社の台湾メーカーによって量産が開始されており、このメーカー各社は前述のように、今後もCSPや委託生産を中心に生産量を増やしていくことが予想されます。また、この状況が刺激となり、日本や韓国メーカー各社もスルーホールフィリング生産を積極的に増やしていく、当社技術の積極的な採用にもつながることが期待できます。

連結貸借対照表

区分	当中間期末 2009年9月30日現在	前期末 2009年3月31日現在
<b>【資産の部】</b>		
流動資産	<b>4,912,276</b>	<b>6,437,244</b>
現金及び預金	2,064,398	2,704,533
受取手形及び売掛金	1,883,850	2,209,204
商品及び製品	422,038	398,764
仕掛品	65,282	516,074
原材料及び貯蔵品	191,246	232,540
繰延税金資産	90,864	96,640
その他	220,723	300,792
貸倒引当金	△ 26,126	△ 21,304
固定資産	<b>4,298,326</b>	<b>4,360,157</b>
有形固定資産	2,965,854	3,102,982
無形固定資産	59,103	65,255
投資その他の資産	1,273,368	1,191,919
<b>資産合計</b>	<b>9,210,603</b>	<b>10,797,402</b>

(単位:千円)

区分	当中間期末 2009年9月30日現在	前期末 2009年3月31日現在
<b>【負債の部】</b>		
流動負債	<b>2,654,376</b>	<b>4,174,998</b>
支払手形及び買掛金	1,030,684	1,864,571
短期借入金	576,220	518,900
一年内返済予定長期借入金	548,004	548,004
リース債務	6,111	5,927
未払法人税等	50,100	46,893
賞与引当金	169,336	167,923
前受金	10,951	689,754
その他	262,967	333,023
固定負債	<b>2,050,475</b>	<b>2,261,845</b>
長期借入金	1,291,660	1,565,662
リース債務	174,800	177,903
退職給付引当金	475,604	422,428
その他	108,410	95,852
<b>負債合計</b>	<b>4,704,851</b>	<b>6,436,844</b>
<b>【純資産の部】</b>		
株主資本	<b>4,819,181</b>	<b>4,842,749</b>
資本金	922,562	922,562
資本剰余金	875,211	875,211
利益剰余金	3,367,701	3,391,269
自己株式	△ 346,293	△ 346,293
評価・換算差額等	△ <b>338,153</b>	△ <b>500,280</b>
その他有価証券評価差額金	△ 104,243	△ 202,308
繰延ヘッジ損益	—	△ 2,605
為替換算調整勘定	△ 233,910	△ 295,367
少数株主持分	<b>24,723</b>	<b>18,088</b>
<b>純資産合計</b>	<b>4,505,751</b>	<b>4,360,557</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>9,210,603</b>	<b>10,797,402</b>

連結損益計算書

区分	当中間期 (自 2009年4月 1日 至 2009年9月30日)	前中間期 (自 2008年4月 1日 至 2008年9月30日)	前期 (自 2008年4月 1日 至 2009年3月31日)
売上高	<b>4,191,109</b>	<b>5,783,995</b>	<b>10,788,574</b>
売上総利益	<b>1,889,840</b>	<b>2,627,757</b>	<b>4,387,363</b>
販売費及び一般管理費	<b>1,742,430</b>	<b>2,022,421</b>	<b>3,843,987</b>
営業利益	<b>147,409</b>	<b>605,335</b>	<b>543,375</b>
経常利益	<b>193,044</b>	<b>564,778</b>	<b>320,637</b>
税金等調整前四半期(当期)純利益	<b>90,500</b>	<b>563,206</b>	<b>135,098</b>
四半期(当期)純利益	<b>59,950</b>	<b>355,265</b>	<b>2,408</b>

(単位:千円)

連結キャッシュ・フロー計算書

区分	当中間期 (自 2009年4月 1日 至 2009年9月30日)	前中間期 (自 2008年4月 1日 至 2008年9月30日)	前期 (自 2008年4月 1日 至 2009年3月31日)
営業活動による キャッシュ・フロー	△ 224,481	1,040,513	1,441,283
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 152,834	△ 406,767	△ 766,844
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 313,729	△ 353,259	154,186
現金及び現金同等物 に係る換算差額	21,322	△ 43,633	△ 187,057
現金及び現金同等物 の増加額	△ 669,722	236,852	641,568
現金及び現金同等物 の期首残高	2,496,748	1,855,179	1,855,179
現金及び現金同等物 の四半期末(期末)残高	1,827,026	2,092,032	2,496,748

(単位:千円)

株主還元について

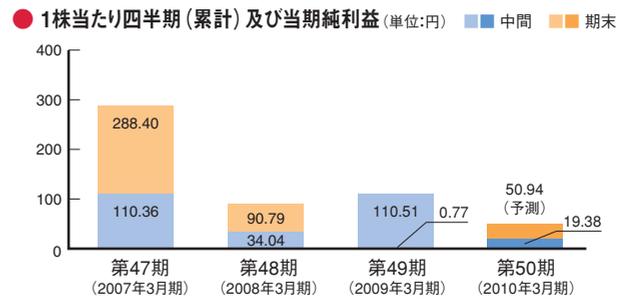
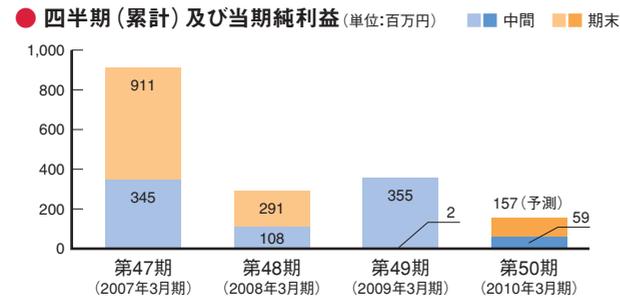
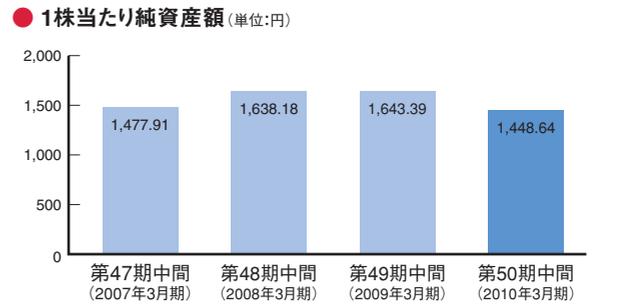
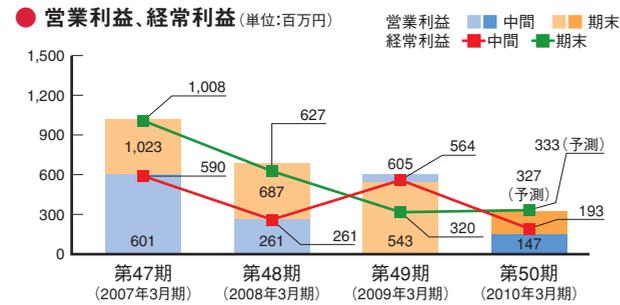
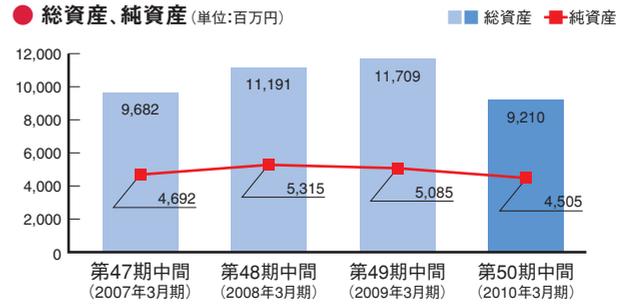
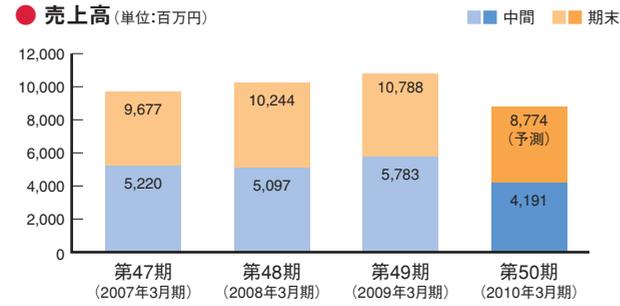
将来の事業展開と経営体質の強化のために適正な自己資本比率を維持しつつ、できるだけ配当性向を高めていくことを利益配分に関する基本方針としております。自己資本は、今後の事業活動や経営基盤の強化に有効活用してまいります。

配当金(円)	第48期		第49期		第50期	
	中間	期末	中間	期末	中間	期末
	30	30	30	27	27	27

株主優待

回数 年に2回  
対象 毎年3月末日及び9月末日の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上保有の株主様  
内容 2,500円相当の品をオリジナルカタログよりお選びいただけます



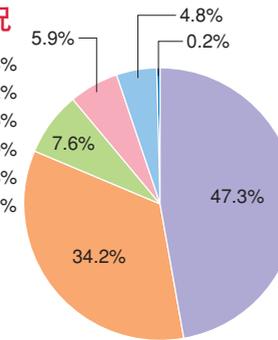


● 株式の状況

発行済株式総数 ..... 3,250,500株  
株主数 ..... 3,958名

● 所有者別株式分布状況

- その他国内法人 1,536,000株 47.3%
- 個人・その他 1,112,928株 34.2%
- 外国法人等 246,731株 7.6%
- 金融機関 191,300株 5.9%
- 自己名義株式 157,237株 4.8%
- 証券会社 6,304株 0.2%



● 大株主の状況

株主名	持株数(株)	出資比率(%)
粕谷 佳允	160,100	5.2
エフ ビー エフ 2000, エル. ビー.	113,500	3.7
日本バーカライジング株式会社	113,500	3.7
日本高純度化学株式会社	110,000	3.6
荏原実業株式会社	100,000	3.2
株式会社スレイ	100,000	3.2
日本化学産業株式会社	93,000	3.0
中央化学産業株式会社	82,600	2.7
神谷理研株式会社	80,000	2.6
栄電子工業株式会社	80,000	2.6
株式会社ユニゾーン	80,000	2.6

(注) 出資比率は自己株式(157,237株)を控除して計算してあります。

- 商号 荏原ユーザライト株式会社
- 本社所在地 東京都台東区台東四丁目19番9号 山口ビル7
- 設立 1968年(昭和43年)4月1日
- 資本金 922,562,500円
- 事業所 【国内】  
大阪支店 名古屋支店 高崎支店 浜松営業所  
九州営業所 総合研究所 新潟工場  
【連結子会社】  
・荏原ユーザライト(上海)貿易有限公司  
広州分公司  
・荏原ユーザライト貿易(深圳)有限公司  
蘇州事務所  
・台湾荏原ユーザライト股份有限公司  
・EBARA-UDYLITE (KOREA) CO., LTD.  
・EBARA-UDYLITE (ASIA-PACIFIC) CO., LTD.  
・EBARA-UDYLITE AMERICA, S.A.DE C.V.  
・EBARA-UDYLITE VIETNAM CO., LTD.  
・EBARA-UDYLITE (HONG KONG) CO., LTD.  
【関連会社】  
・PROGRESSIVE EU CHEMICALS PVT. LTD.

● 役員一覧

- 代表取締役社長 粕谷 佳允
- 取締役副社長 小澤 恵二
- 専務取締役 大木 繁司
- 専務執行役員 上谷 正明
- 常務取締役 中澤 隆司
- 常務執行役員 君塚 亮一
- 取締役常務執行役員 山本 雅司
- 社外取締役 吉川 豊
- 執行役員 中村 憲二
- 執行役員 石井 洋二
- 執行役員 木村 隆男
- 常勤監査役 大野 寛二
- 社外監査役 伴 峰夫
- 社外監査役 岸 富也
- 社外監査役 高中 正彦

● 従業員数 連結 299名(54名) 単体 223名(12名)

(注) 臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。